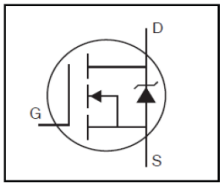
- 贴片
- 先进工艺技术
- 超低导通电阻
- 动态 dv/dt 额定值
- 快速开关
- 雪崩完全额定
- 无铅

HEXFET ®功率MOSFET



V_{DSS}	55V
$R_{DS(on)}$	0.045Ω
I_D	3.7A



SOT-223

G	D	S
Gate	Drain	Source

描述

国际整流器公司（International Rectifier）推出的第五代 HEXFET 采用先进的工艺技术，实现了单位硅面积极低的导通电阻。这一优点与 HEXFET 功率 MOSFET 众所周知的快速开关速度和坚固耐用的器件设计相结合，为设计人员提供了一种可用于各种应用的极为高效和可靠的器件。

SOT-223 封装专为表贴工艺设计，可兼容气相焊、红外焊或波峰焊工艺。其独特的封装设计使其能够像其他 SOT 或 SOIC 封装一样轻松实现自动拾放，同时由于散热片面积增大，还具有散热性能更佳这一额外优势。在典型的表面贴装应用中，功率耗散可达1.0W。

Base Part Number	Package Type	Standard Pack		Orderable Part Number
		Form	Quantity	
IRFL4105PbF	SOT-223	Tape and Reel	2500	IRFL4105PbF

绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Max.	Units
I_D @ T_A = 25°C	Continuous Drain Current, V_{GS} @ 10V ⑥	5.2	A
I_D @ T_A = 25°C	Continuous Drain Current, V_{GS} @ 10V ⑤	3.7	
I_D @ T_A = 70°C	Continuous Drain Current, V_{GS} @ 10V ⑤	3.0	
I_{DM}	Pulsed Drain Current ①	30	
P_D @T_A = 25°C	Maximum Power Dissipation (PCB Mount) ⑥	2.1	W
P_D @T_A = 25°C	Maximum Power Dissipation (PCB Mount) ⑤	1.0	
	Linear Derating Factor (PCB Mount) ⑤	8.3	mW/°C
V_{GS}	Gate-to-Source Voltage	± 20	V
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy (Thermally Limited) ②	110	mJ
I_{AR}	Avalanche Current ①	3.7	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ①	0.10	mJ
dv/dt	Peak Diode Recovery dv/dt ③	5.0	V/ns
T_J T_{STG}	Operating Junction and Storage Temperature Range	-55 to + 150	°C

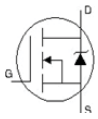
热阻

Symbol	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient (PCB Mount, steady state) ⑤	90	120	°C/W
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient (PCB Mount, steady state) ⑥	50	60	

电气特性 @T_J = 25°C（除非另有说明）

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
$V_{(BR)DSS}$	Drain-to-Source Breakdown Voltage	55	---	---	V	V_{GS} = 0V, I_D = 250µA
$\Delta V_{(BR)DSS}/\Delta T_J$	Breakdown Voltage Temp. Coefficient	---	0.058	---	V/°C	Reference to 25°C, I_D = 1mA
$R_{DS(on)}$	Static Drain-to-Source On-Resistance	---	---	0.045	Ω	V_{GS} = 10V, I_D = 3.7A ④
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	2.0	---	4.0	V	V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250µA
gfs	Forward Trans conductance	3.8	---	---	S	V_{DS} = 25V, I_D = 1.9A
I_{DSS}	Drain-to-Source Leakage Current	---	---	25	µA	V_{DS} = 55 V, V_{GS} = 0V
		---	---	250		V_{DS} = 44V,V_{GS} = 0V,T_J =150°C
I_{GSS}	Gate-to-Source Forward Leakage	---	---	100	nA	V_{GS} = 20V
	Gate-to-Source Reverse Leakage	---	---	-100		V_{GS} = -20V
Q_g	Total Gate Charge	---	23	35	nC	I_D = 3.7A V_{DS}
Q_{gs}	Gate-to-Source Charge	---	3.4	5.1		= 44V
Q_{gd}	Gate-to-Drain Charge	---	9.8	15		V_{GS} = 10V , See Fig. 6 and 13 ④
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	---	7.1	---	ns	V_{DD} = 28V I_D
t_r	Rise Time	---	12	---		= 3.7A R_G=
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	---	19	---		6.0Ω
t_f	Fall Time	---	12	---		R_D= 7.5Ω, See Fig. 10 ④
C_{iss}	Input Capacitance	---	660	---	pF	V_{GS} = 0V V_{DS}
C_{oss}	Output Capacitance	---	230	---		= 25V
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	---	99	---		f = 1.0MHz, See Fig. 5

源极-漏极额定值与特性

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
I_S	Continuous Source Current (Body Diode)	---	---	1.3	A	MOSFET symbol showing the integral reverse p-n junction diode. 
I_{SM}	Pulsed Source Current (Body Diode) ①	---	---	30		
V_{SD}	Diode Forward Voltage	---	---	1.3	V	T_J = 25°C,I_S = 3.7A,V_{GS} = 0V ④
t_{rr}	Reverse Recovery Time	---	55	82	ns	T_J = 25°C ,I_F = 3.7A
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	---	120	170	nC	di/dt = 100A/µs ④

注:

① 重复额定值；脉冲宽度受最高结温限制。（见图11）

② 初始 T_J = 25°C，L = 16mH，R_G= 25Ω，I_{AS} = 3.7A（见图 12）

③ I_{SD} ≤ 3.7A, di/dt ≤ 110A/µs, V_{DD} ≤ $V_{(BR)DSS}$, T_J ≤ 150°C。

④ 脉冲宽度 ≤ 300µs; 占空比 ≤ 2%。

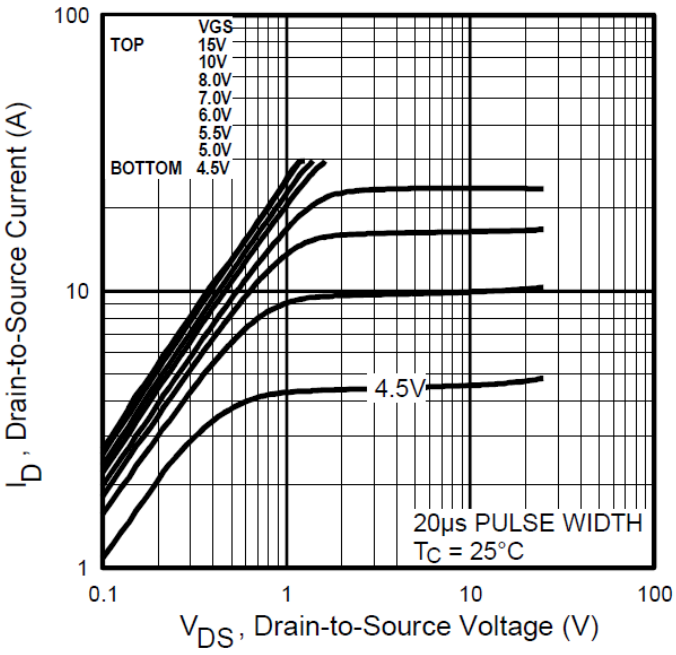


图 1 典型输出特性

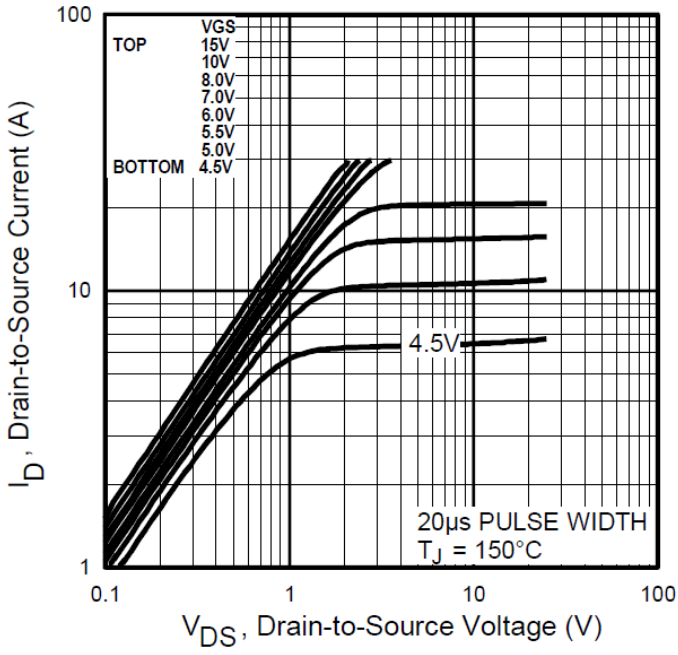


图 2 典型输出特性

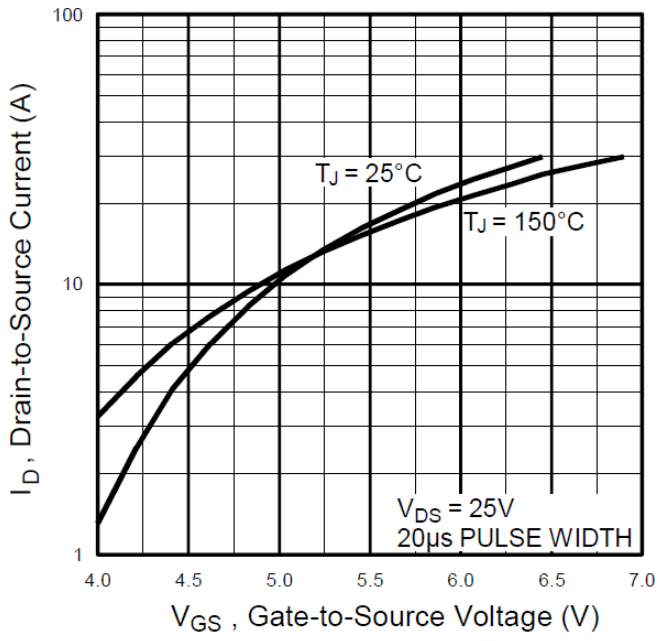


图 3 典型转移特性

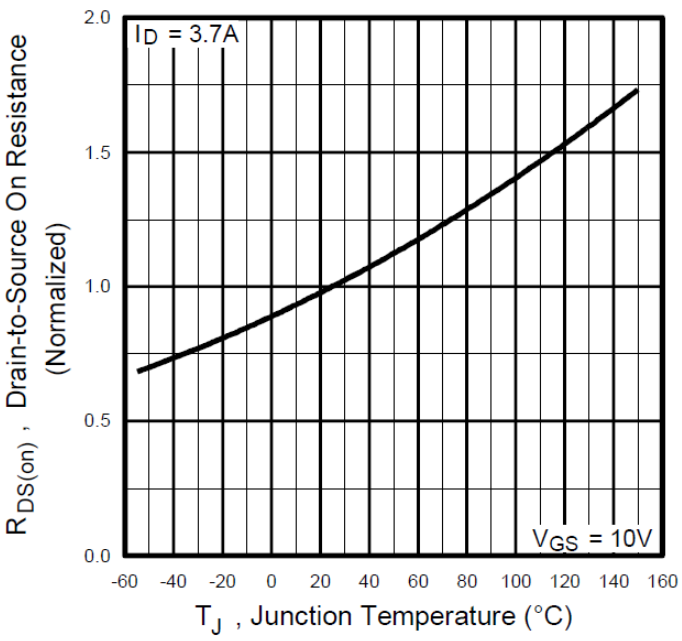


图 4 归一化导通电阻与温度的关系曲线

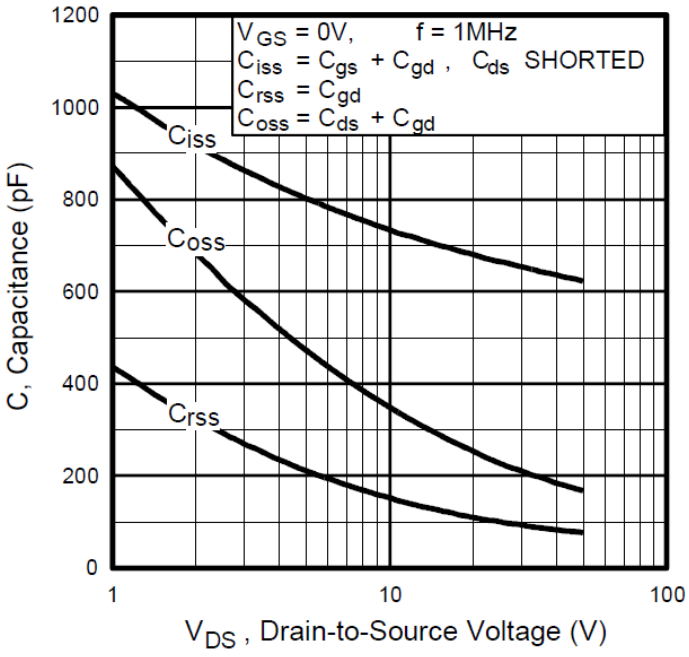


图 5 典型电容与漏源电压关系曲线

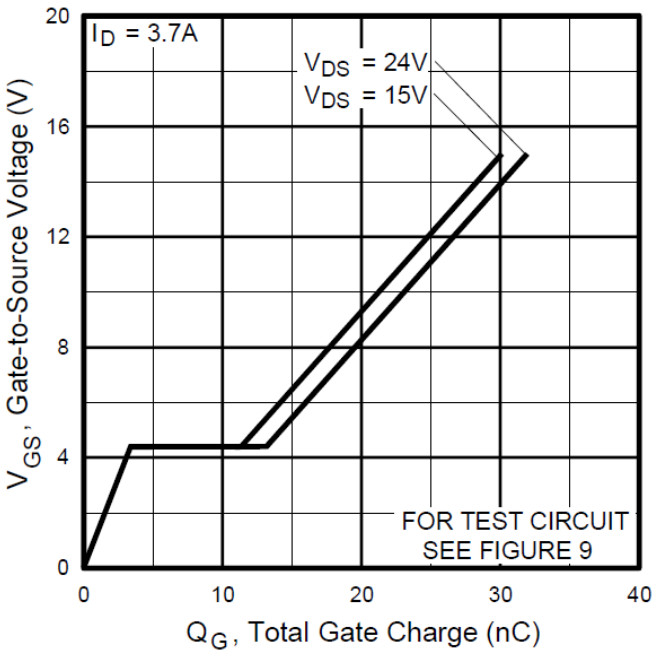


图 6 典型栅极电荷与栅源电压关系曲线

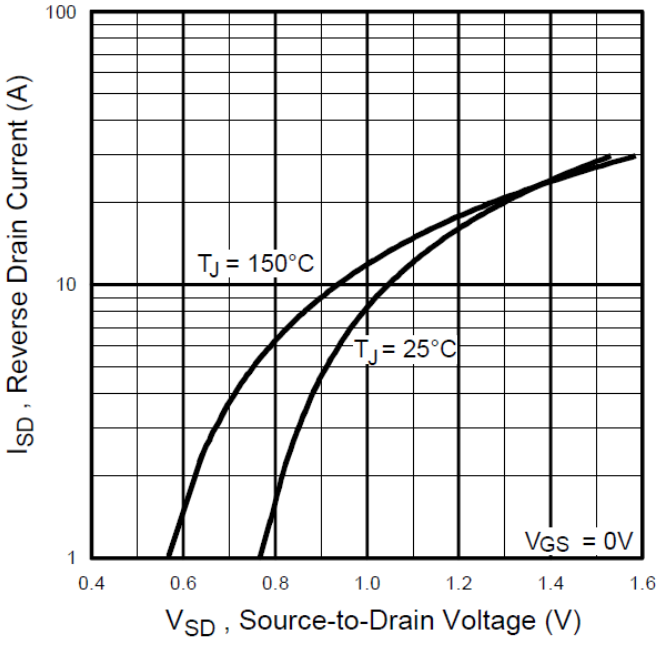


图 7 典型源漏二极管正向电压

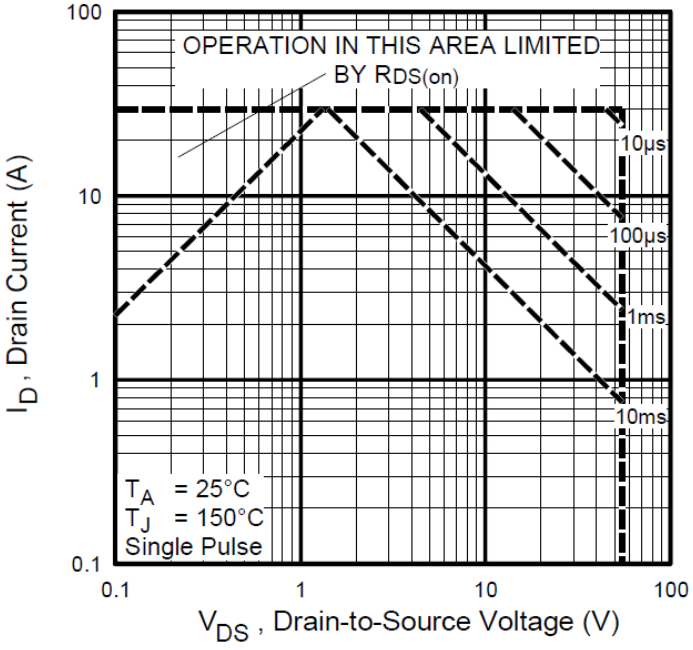


图 8 最大安全工作区

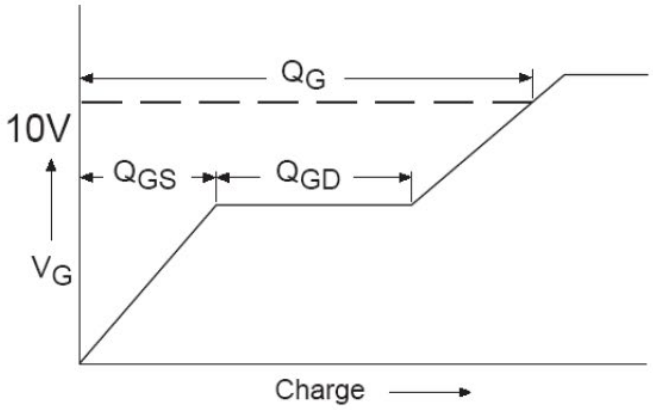


图 9a 基本栅极电荷波形

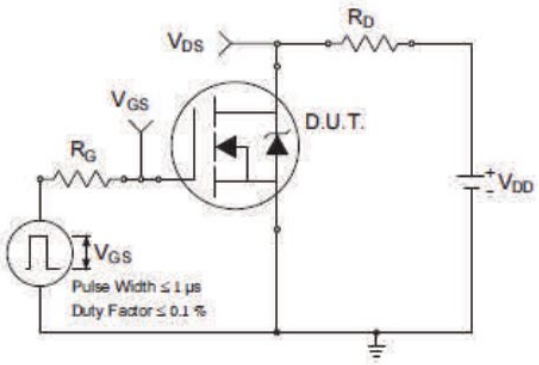


图 10a 开关时间测试电路

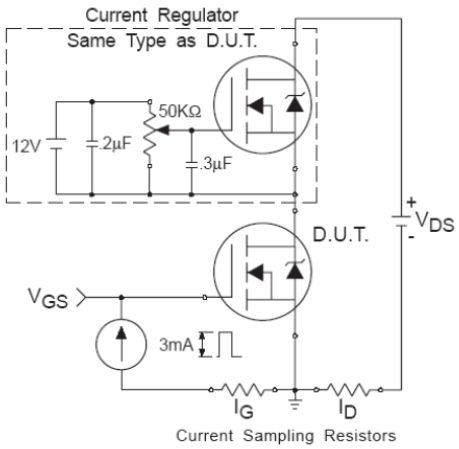


图 9b 栅极电荷测试电路

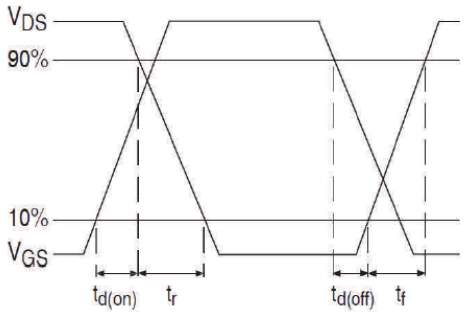


图 10b 开关时间波形

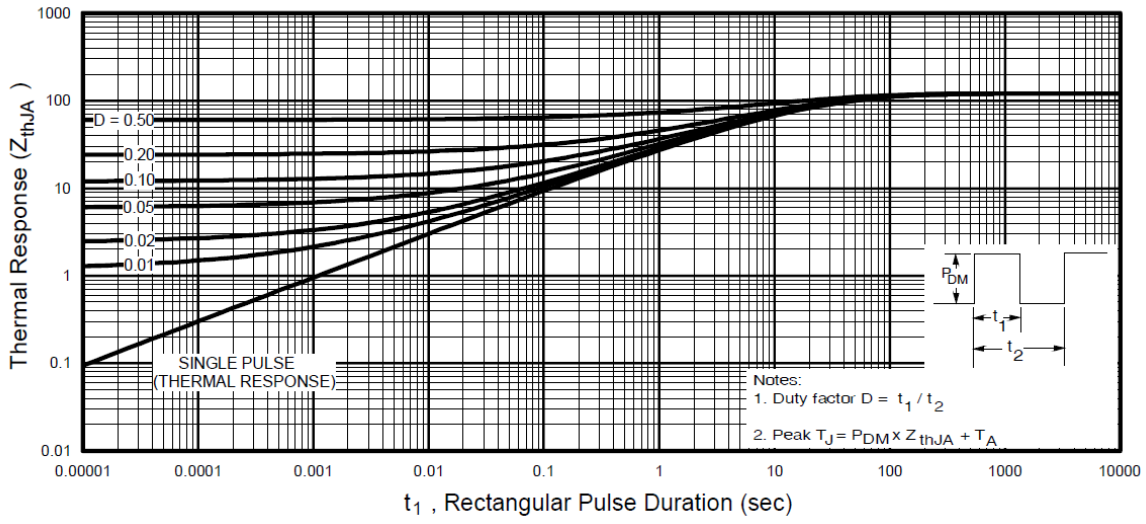


图 11 最大有效瞬态热阻，结至环境

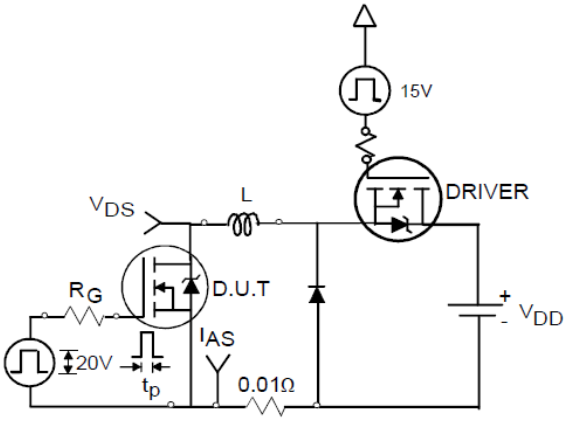


图 12a 未钳位电感性测试电路

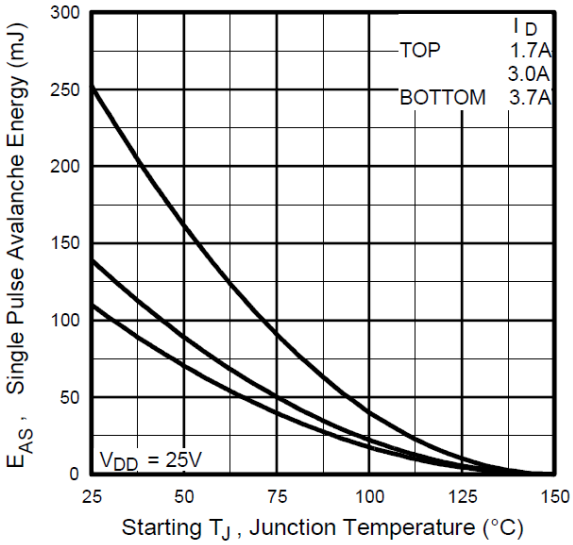


图 12c 最大雪崩能量与漏极电流的关系曲线

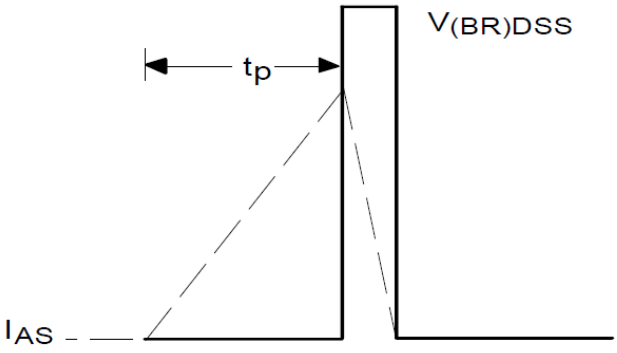


图 12b 未钳位电感波形

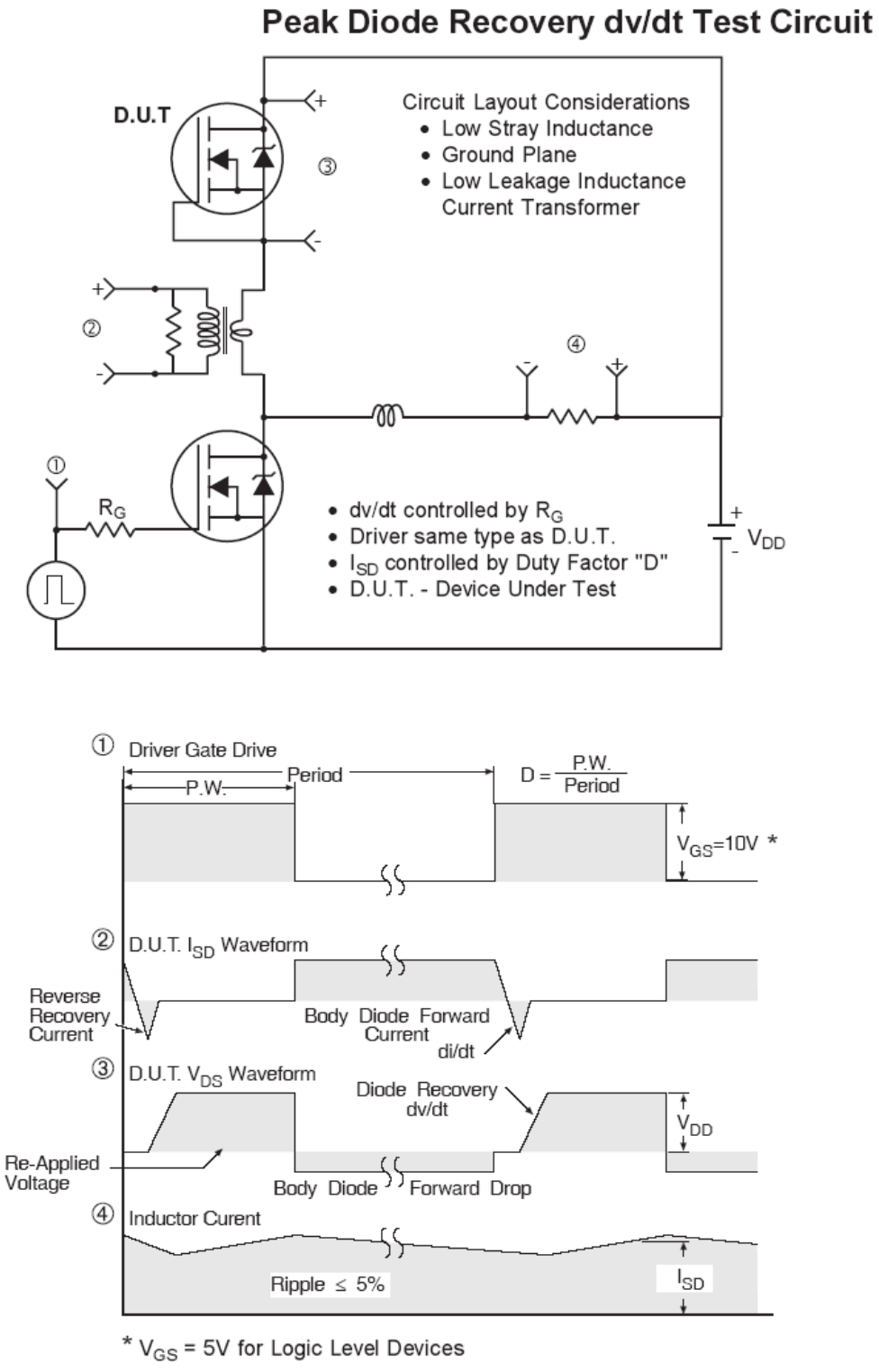
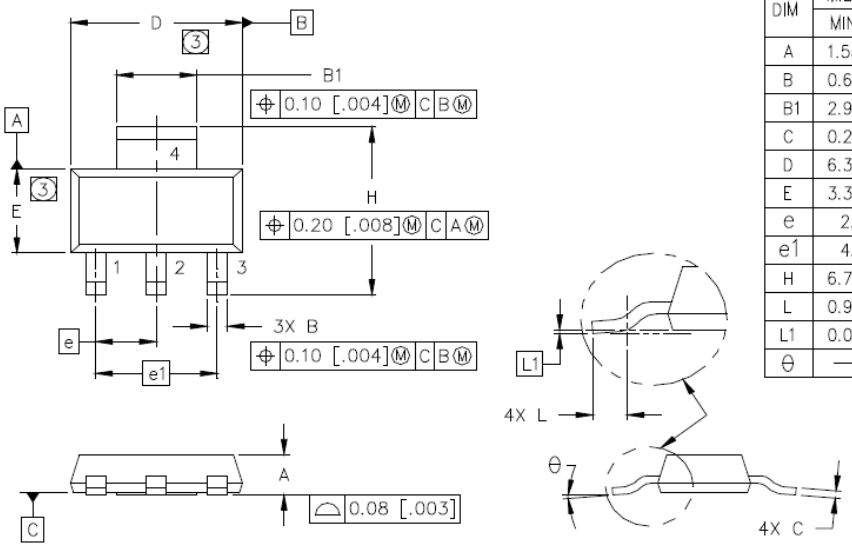
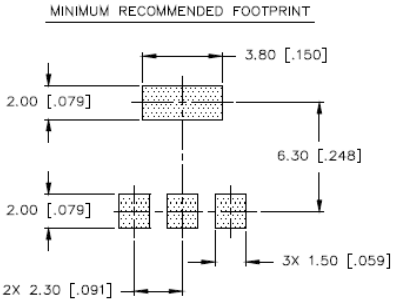


图 13 N沟道 HEXFET® 功率 MOSFET 体内二极管峰值恢复 dv/dt 测试电路

SOT-223 (TO-261AA) 封装外形（尺寸以毫米（英寸）为单位）



DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.55	1.80	.061	.071
B	0.65	0.85	.026	.033
B1	2.95	3.15	.116	.124
C	0.25	0.35	.010	.014
D	6.30	6.70	.248	.264
E	3.30	3.70	.130	.146
e	2.30 BSC		.0905 BSC	
e1	4.60 BSC		.181 BSC	
H	6.71	7.29	.264	.287
L	0.91	—	.036	—
L1	0.061 BSC		.0024 BSC	
θ	—	10°	—	10°



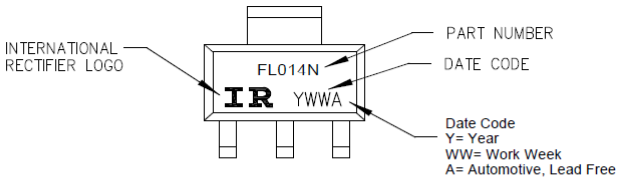
LEAD ASSIGNMENTS

1 = GATE
2 = DRAIN
3 = SOURCE
4 = DRAIN

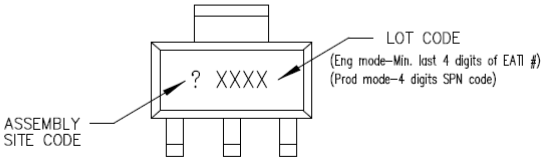
NOTES:

1. DIMENSIONING & TOLERANCING PER ASME Y14.5M—1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
4. OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE TO—261AA.
5. DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS [INCHES].

SOT-223(TO-261AA) 零件标识信息



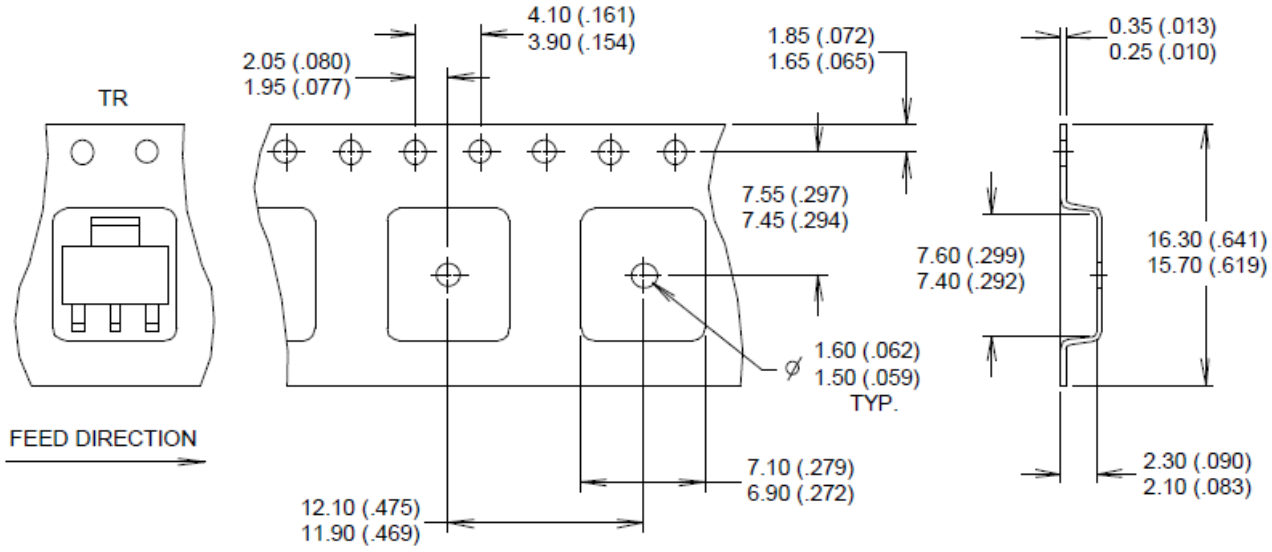
TOP MARKING



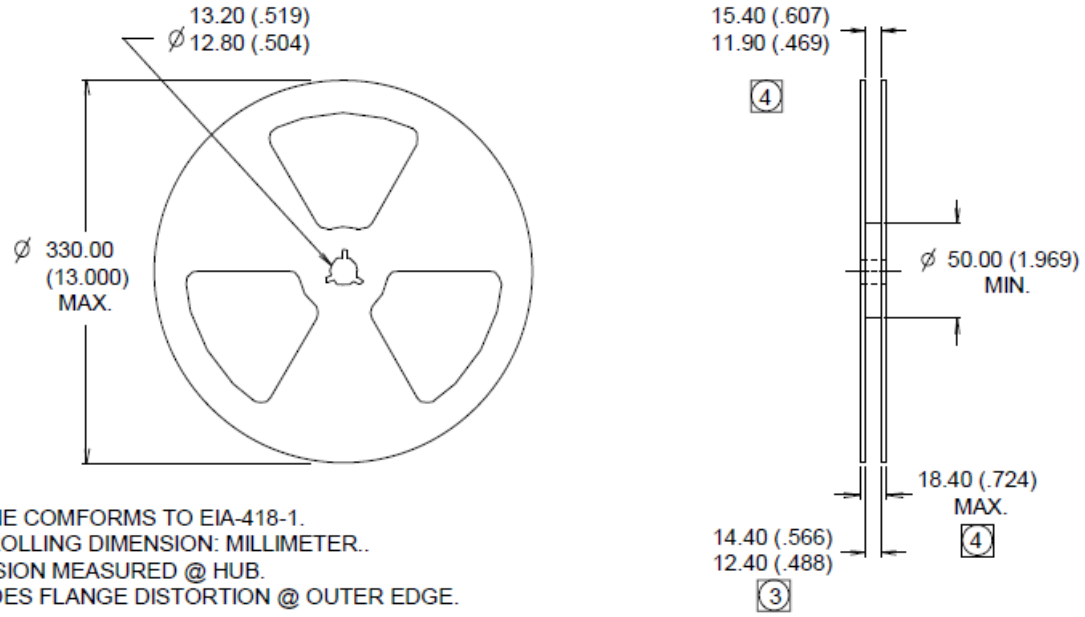
BOTTOM MARKING

注：有关最新图纸，请参阅英飞凌网站 https://www.infineon.cn/ 。

SOT-223(TO-261AA) 卷带包装（尺寸单位为毫米（英寸））



NOTES :
1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
2. OUTLINE CONFORMS TO EIA-481 & EIA-541.
3. EACH Ø330.00 (13.00) REEL CONTAINS 2,500 DEVICES.



NOTES :
1. OUTLINE COMFORMS TO EIA-418-1.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER..
3. DIMENSION MEASURED @ HUB.
4. INCLUDES FLANGE DISTORTION @ OUTER EDGE.

注：有关最新图纸，请参阅英飞凌网站 https://www.infineon.cn/ 。

Qualification Information†

Qualification Level	Industrial (per JEDEC JESD47F) ††	
Moisture Sensitivity Level	SOT-223	MSL1 (per JEDEC J-STD-020D) ††
RoHS Compliant	Yes	

† 质量标准相关信息请参阅英飞凌网站 https://www.infineon.cn/ 。

†† 产品发布时的 JEDEC 标准适用版本。

修订记录

Date	Comments
5/27/2016	• Updated datasheet with corporate template. • Added disclaimer on last page.

Trademarks of Infineon Technologies AG
µHVIC™, µIPM™, µPFC™, AU-ConvertIR™, AURIX™, C166™, CanPAK™, CIPOS™, CIPURSE™, CoolDP™, CoolGaN™, COOLiR™, CoolMOS™, CoolSET™, CoolSiC™, DAVE™, DI-POL™, DirectFET™, DrBlade™, EasyPIM™, EconoBRIDGE™, EconoDUAL™, EconoPACK™, EconoPIM™, EiceDRIVER™, eupec™, FCOS™, GaNpowIR™, HEXFET™, HITFET™, HybridPACK™, iMOTION™, IRAM™, ISOFACE™, IsoPACK™, LEDrivIR™, LITIX™, MIPAQ™, ModSTACK™, my-d™, NovalithIC™, OPTIGA™, OptiMOS™, ORIGA™, PowIRaudio™, PowIRStage™, PrimePACK™, PrimeSTACK™, PROFET™, PRO-SIL™, RASIC™, REAL3™, SmartLEWIS™, SOLID FLASH™, SPOC™, StrongIRFET™, SupIRBuck™, TEMPFET™, TRENCHSTOP™, TriCore™, UHVIC™, XHP™, XMC™

Trademarks updated November 2015

Other Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2016-04-19
Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2016 Infineon Technologies AG. All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com

Document reference
ifx1

IMPORTANT NOTICE
The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or **characteristics ("Beschaffenheitsgarantie") .**

With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document **is subject to customer's compliance with its** obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in **customer's applications.**

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the **responsibility of customer's technical departments** to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

Please note that this product is not qualified according to the AEC Q100 or AEC Q101 documents of the Automotive Electronics Council.

WARNINGS
Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may **not** be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.

免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。
由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。
因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 http://www.infineon.com
英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。
您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

版本 **2026-09-22**

Infineon Technologies AG 出版，
德国 **Neubiberg 85579**

版权 © **2026 Infineon Technologies AG**
及其关联公司。
保留所有权利。

Do you have a question about this document?

Email:

erratum@infineon.com

重要通知

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称 "英飞凌"）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称 "产品"），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上述合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文档中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：
由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称"安全漏洞"），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文档包含或引用软件：
根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码(binary code)形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 **https://www.infineon.com**。